

股票代號：6552



易華電子股份有限公司
JMC ELECTRONICS CO., LTD

2024/11/27

本簡報中對產業未來的展望為反映本公司截至目前為止的看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。



-Professional Reel-to-Reel Fine-Pitch Service

Confidential



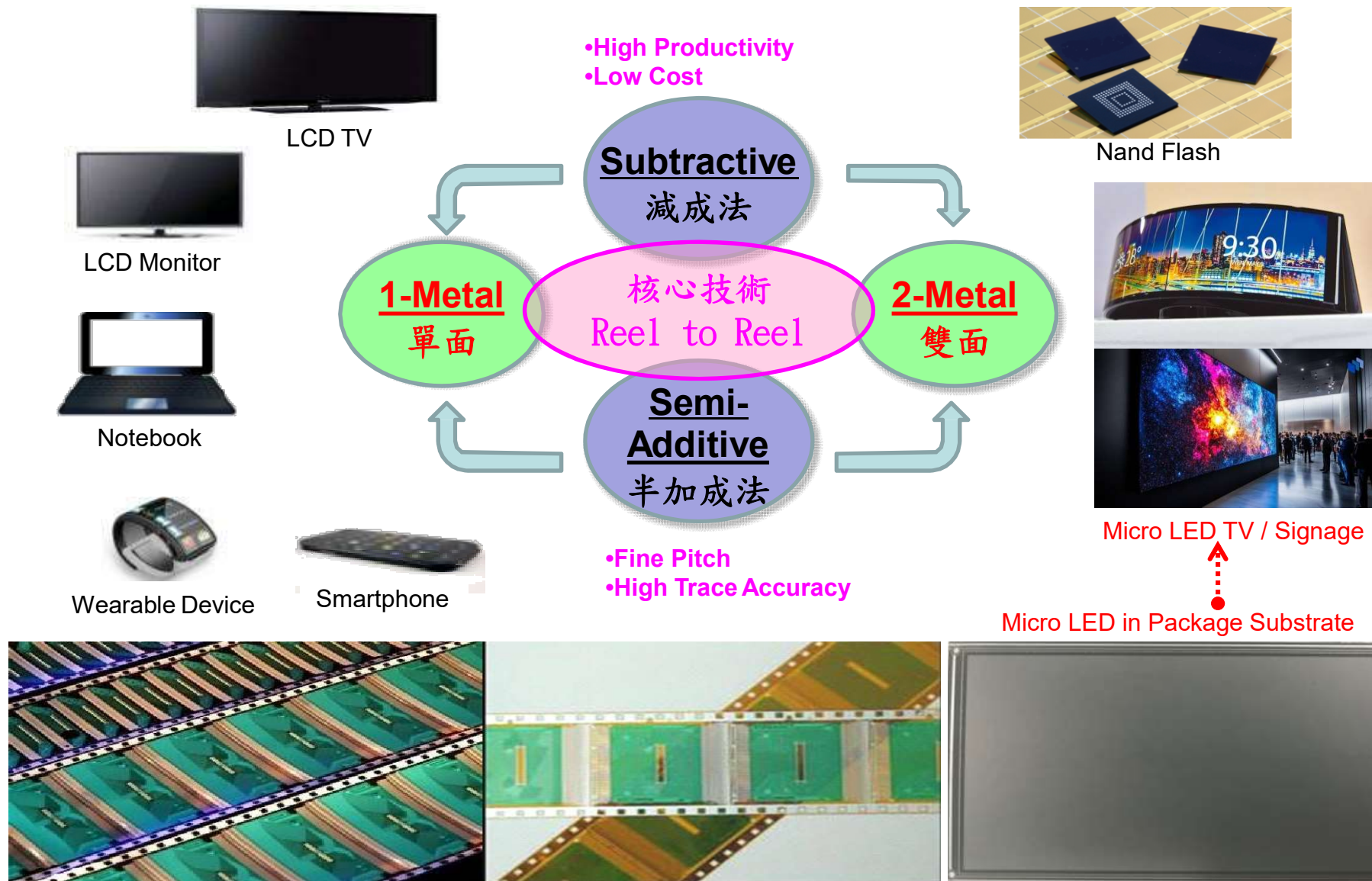
一、公司概况-基本資料

- 公司設立：1973年10月6日(原名台灣住礦電子股份有限公司)
- 董 事 長：萬文財
- 總 經 理：李宛霞
- 實收資本：新台幣8.3億元
- 主要股東：長華42.8%、南茂10%
- 員工人數：661人(截至2024年10月底)
- 主要產品：捲帶式高階覆晶薄膜IC基板(Reel to Reel Chip on Film)
- 地 址：高雄市楠梓區新開發路8號

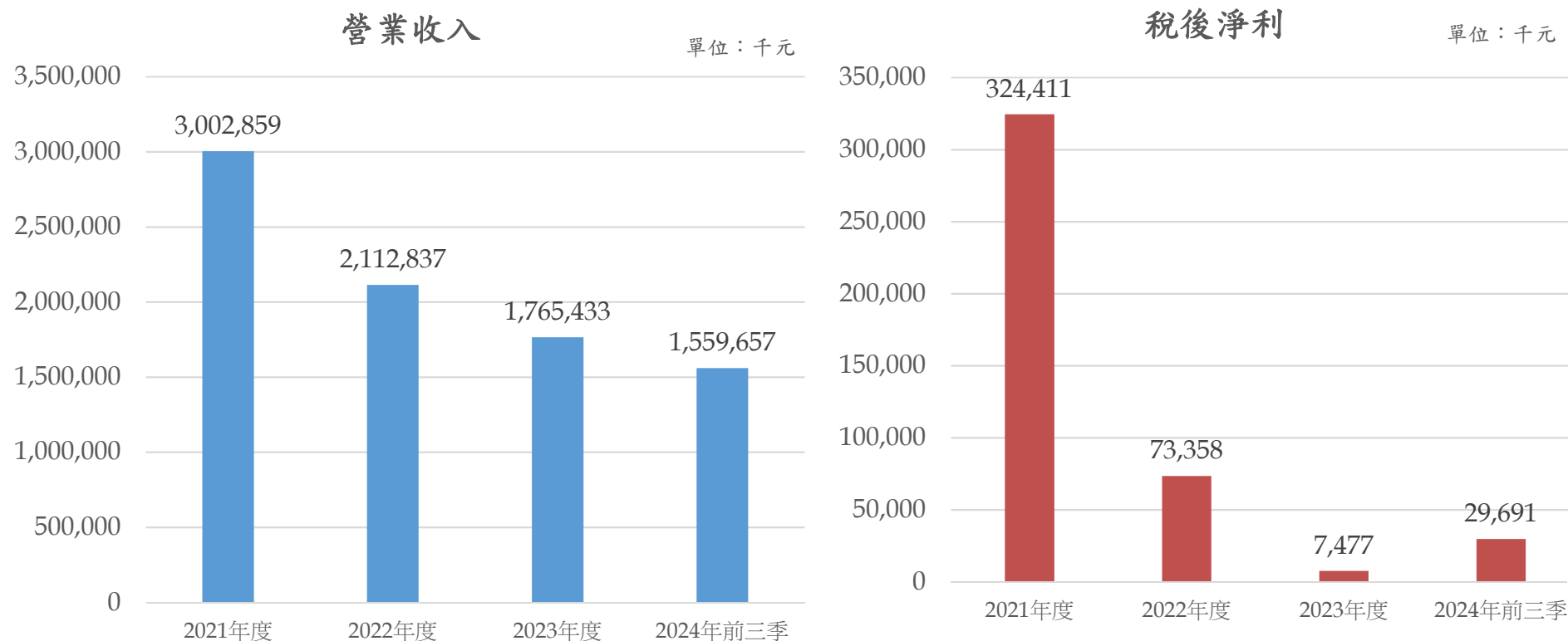


-Professional Reel-to-Reel Fine-Pitch Service

一、公司概況-產品應用



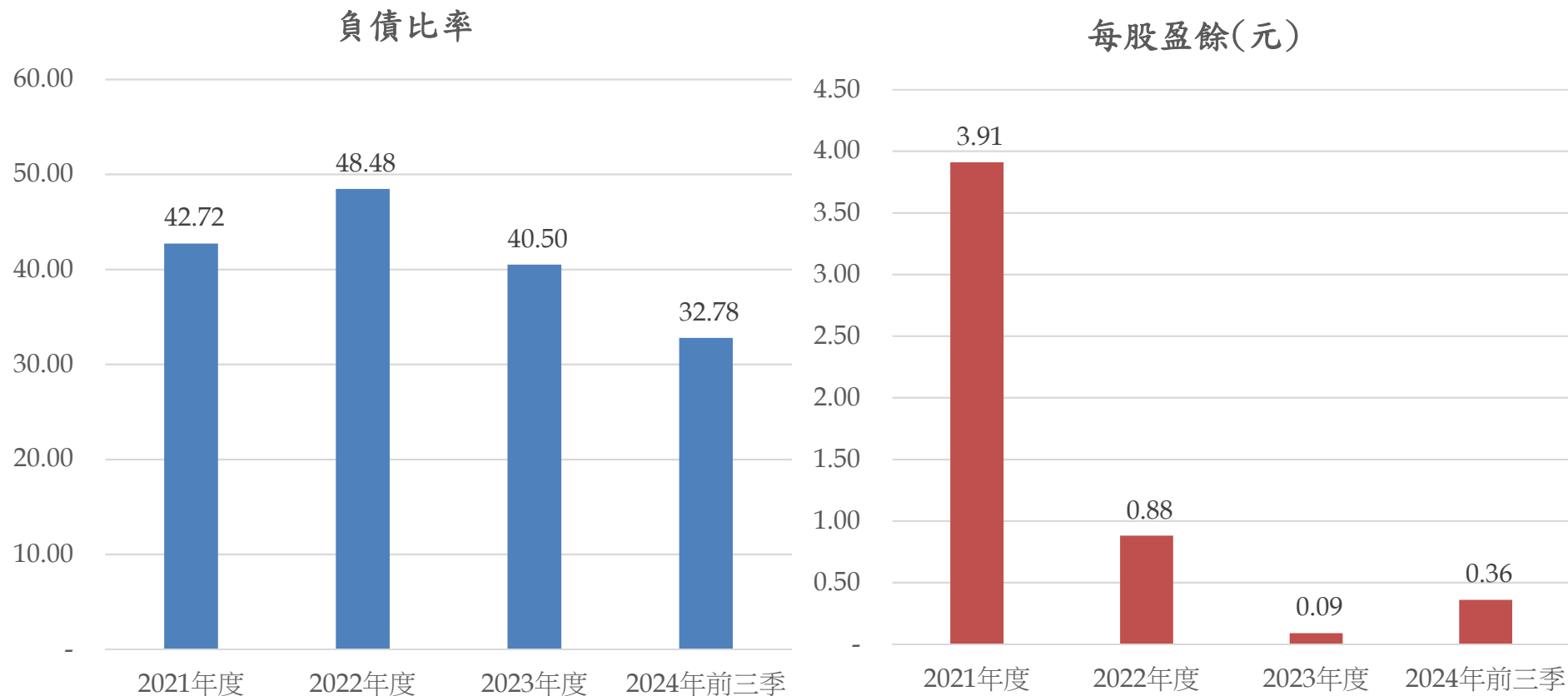
二、營運績效-歷年營收及獲利



單位：新台幣千元

年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年前三季
營業收入	3,002,859	2,112,837	1,765,433	1,559,657
稅後淨利	324,411	73,358	7,477	29,691

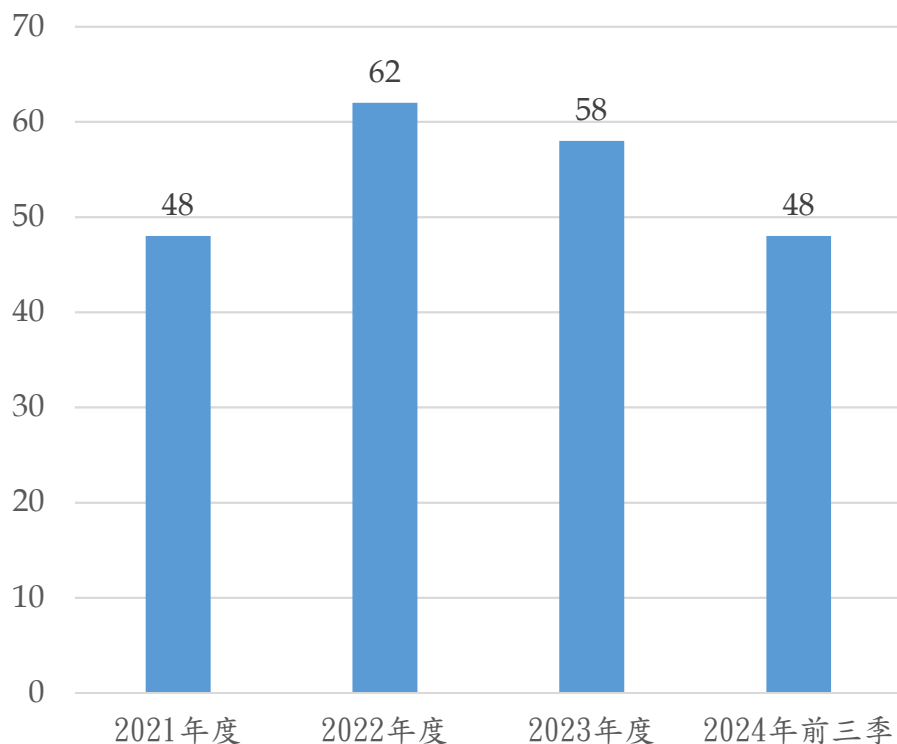
二、營運績效-財務比率分析



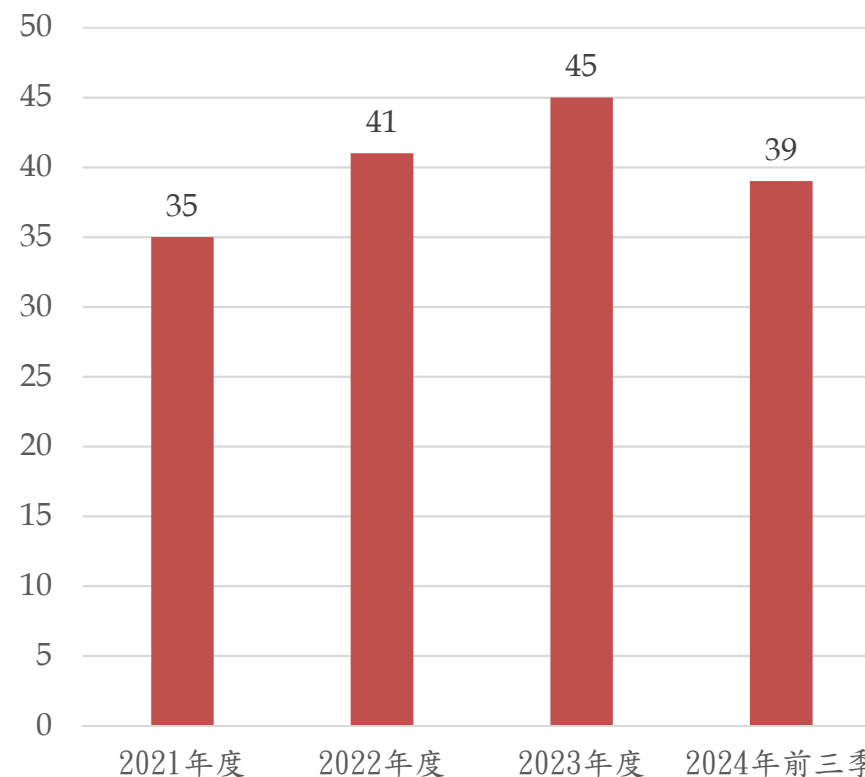
年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年前三季
負債比率	42.72	48.48	40.5	32.78
每股盈餘(元)	3.91	0.88	0.09	0.36

二、營運績效-財務比率分析

應收款項週轉天數

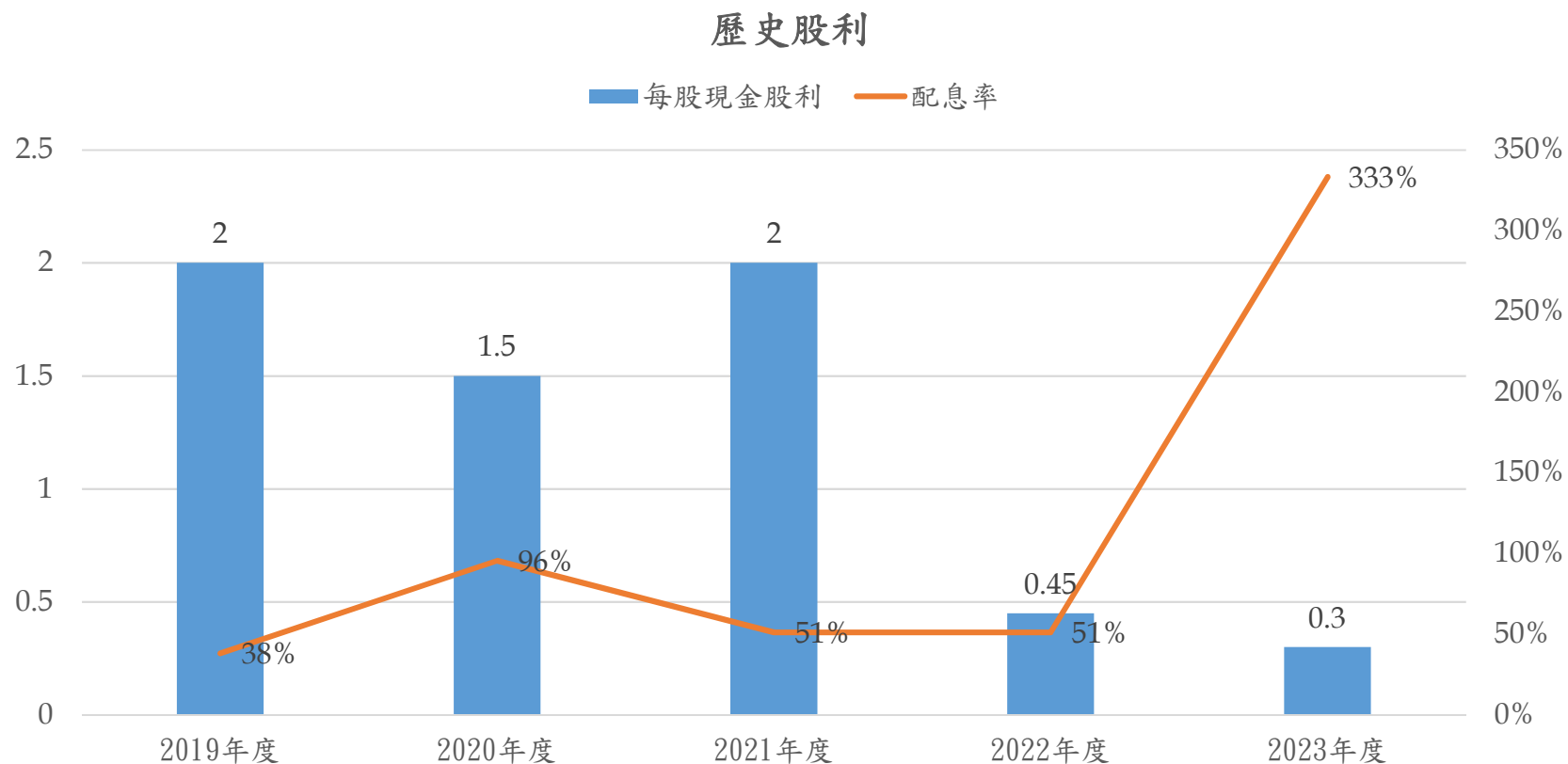


平均銷售天數



年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年前三季
應收帳款週轉天數	48	62	58	48
平均銷售天數	35	41	45	39

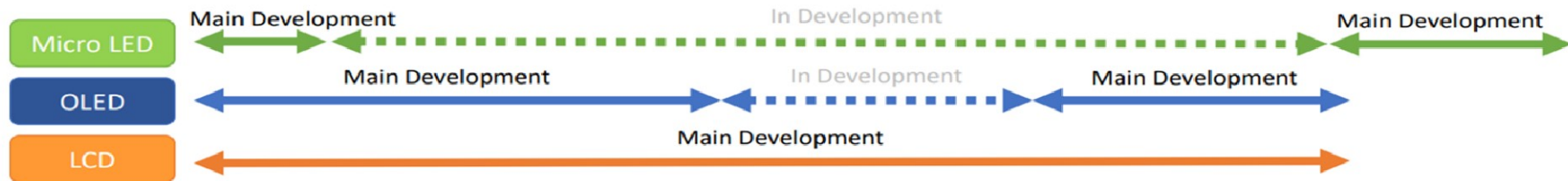
二、營運績效-歷史股利



年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
每股現金股利	2	1.5	2	0.45	0.3
股息率	38%	96%	51%	51%	333%

三、市場狀況與業務展望 - 不同技術的面板開發趨勢

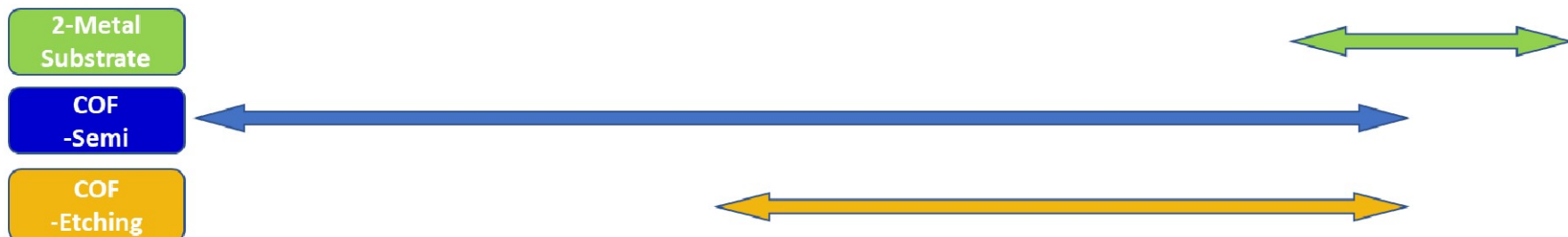
Display technology



Application

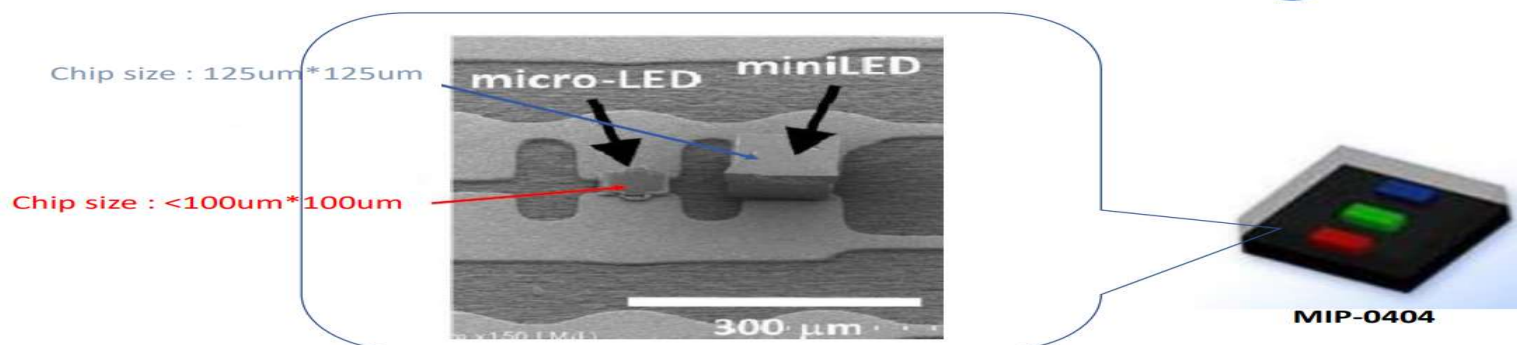


JMC Technology



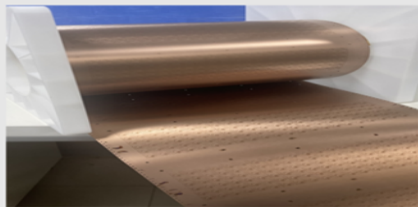
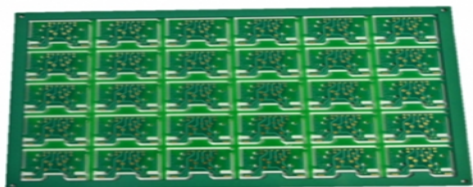
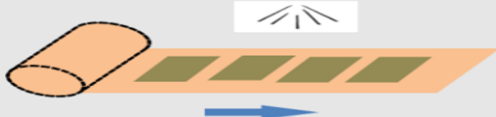
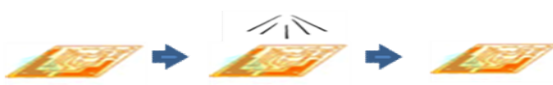
三、市場狀況與業務展望 - MIP(Micro LED in Package)

1. MIP(Micro LED in Package)結構介紹



- 進入Micro LED產品的微型世界中，微小化的晶片需要高精度及高解析度線路載板進行對應，且配合巨量轉移製程，基板線路的重複性要求極高
- 傳統電路板面臨精度不足，而玻璃/藍寶石基板等生產成本過高，且不適用於MIP的封裝型態，市場上需要介於傳統電路板及玻璃載板之間的高性能載板

2. MIP Substrate製程差異比較

	Reel to Reel Process (JMC)	Panel Process(Other PCB)
Manufacturing Process		
Manufacturing Form		

三、市場狀況與業務展望 – 市場開發

	1-Metal COF	2-Metal IC Substrate
目前	<u>戰爭、通貨膨脹、經濟成長停滯，影響全球民生需求</u> *2020及2021年TV及IT面板產值在大幅成長。但自2022年起，高成長之市場需求下滑，2023年面板廠持續減產及去化庫存。2024年面板市場回到傳統需求模式，預期2025年將可望回歸為穩定需求市場。 *手機面板用驅動IC晶片，COP設計增加，因此COF使用量 持續降低。 *手錶手環兼具健康管理功能成為顯學，COF在此領域用量需求穩定成長。	<u>LED直顯和背光市場並進，應用開枝散葉</u> *2021年堪稱Mini LED相關產品增量的一年。2022年下世代顯示技術發展加速，各品牌廠積極發表新型顯示技術；其中不乏Micro LED相關產品，足見廠商重視先進顯示產品市場發展。 *2023年Mini/Micro LED的開發與應用積極活絡。 *2024年易華的2 Metal IC Substrate，已經開始應用於Micro LED產品。 *2025年易華的2 Metal IC Substrate 應用於Micro LED產品，有機會放量生產。
未來	<u>新設計、新應用…，趨勢不變；需求時間遞延</u> * TV面板 – 4K -> 8K趨勢已然呈現，靜待市場需求。↑ * Monitor/NB/Tablet面板 – 開始出現無邊框應用；由COG 轉為COF的設計。↑ *車用面板 – 開始COF的設計。↑ *手機面板-使用COP/COG設計，COF用量減少。↓ *Wearable面板-穿戴裝置面板由於邊框要求，陸續由COG轉為COF 設計，市場需求穩定成長。↑	<u>新設計、新應用…，未來可期</u> *2 Metal IC Substrate for Micro LED的應用，將擴展增加新客戶。↑ *將拓展其他IC Substrate的應用領域。→

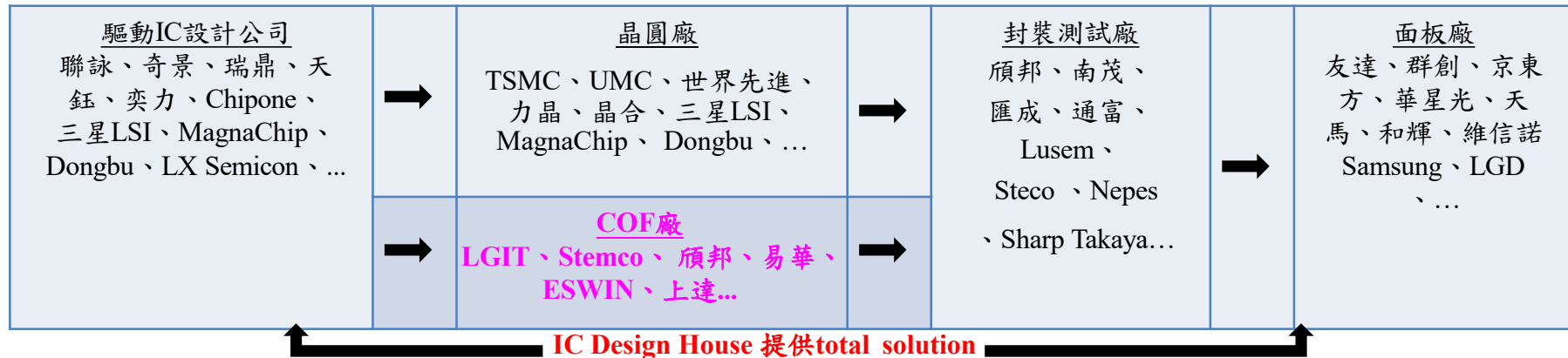
三、市場狀況與業務展望 - 技術與產品開發

✓ 提供客戶全方位軟性IC substrate產品之供應商

製程	競爭優勢	產品/技術能力	產品應用
1-Metal Sub 減成法	*生產速度快，效率高。 *技術能力自主，生產良率穩定。	*COF - 銅厚#~8um - 線路>=20um Pitch - 腳數=<1440 Channel/48mm	@ TV @ MNT @ NB @Vehicle
1-Metal Semi 半加成法	*高精度尺寸控制的COF產品，可以提升面板模組組裝良率；協助客戶降低Total Cost。 *生產良率高及品質穩定性佳，在生產成本上具有絕對的競爭優勢。	*COF - 銅厚#~12um - 線路>=18/16/14um Pitch - 腳數=<1900 Channel/48mm =<3000 Channel/70mm	@ TV @ MNT @ NB @Vehicle @ Wearable、Mobile、Tablet
2-Metal 雙面法	*新製程技術開發能力。 *具備設備設計能力。 *成本控制能力佳。	*Micro LED IC Substrate - MIP0404 - MIP0303 - MIP0202 *Thin Film IC Substrate	@ TV、Signage @ NAND Flash

四、產業概況-驅動IC供應鏈

✓ IC Design House提供total solution



✓ COF廠分佈區域

製程技術			1-Metal(單面)減成法 Subtractive(Etching)	1-Metal(單面)半加成法 Semi-Additive(Plating)	2-Metal(雙面)
應用	腳數(Channel)/帶寬		=<1400 /48mm	1400~1900 /48mm	1900~2500 /48mm
			=<2000 /70mm	2000~3000 /70mm	3000~4000 /70mm
產能	韓國	S社	90~100KK	?KK(2-Metal改1-Metal)	7-10KK
		L社	120~130KK	?KK(2-Metal改1-Metal)	5-7KK
	日本	F社	20KK	X	2KK
		C社	70~90KK	X	X
	台灣	易華	40KK	40KK	5KK
		ESWIN 上達	? 15KK	X X	X X

感謝您的聆聽

Thank you for listening

Q&A